

Согласовано

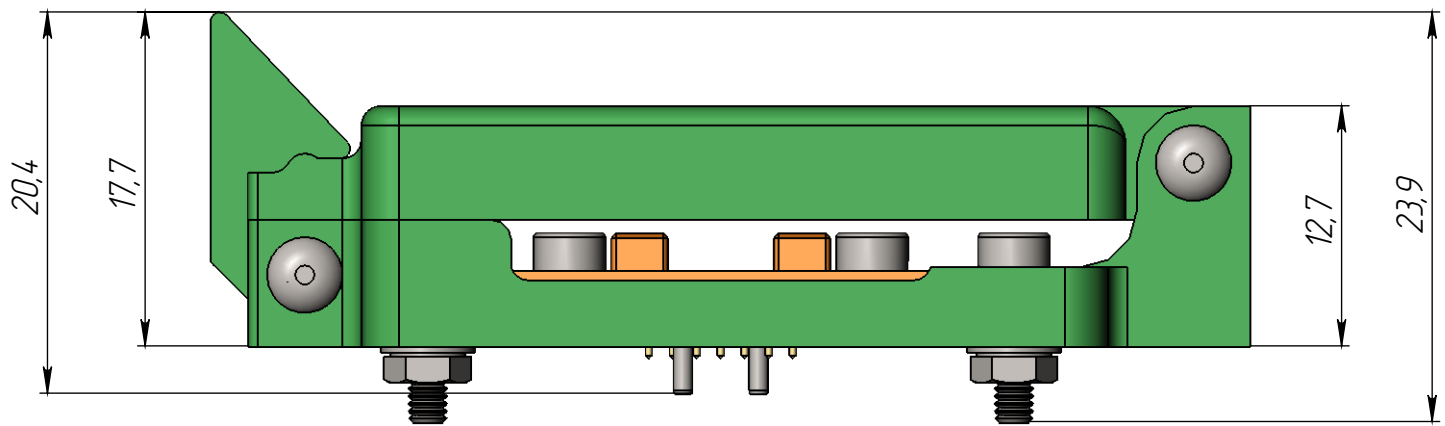
*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2017г.

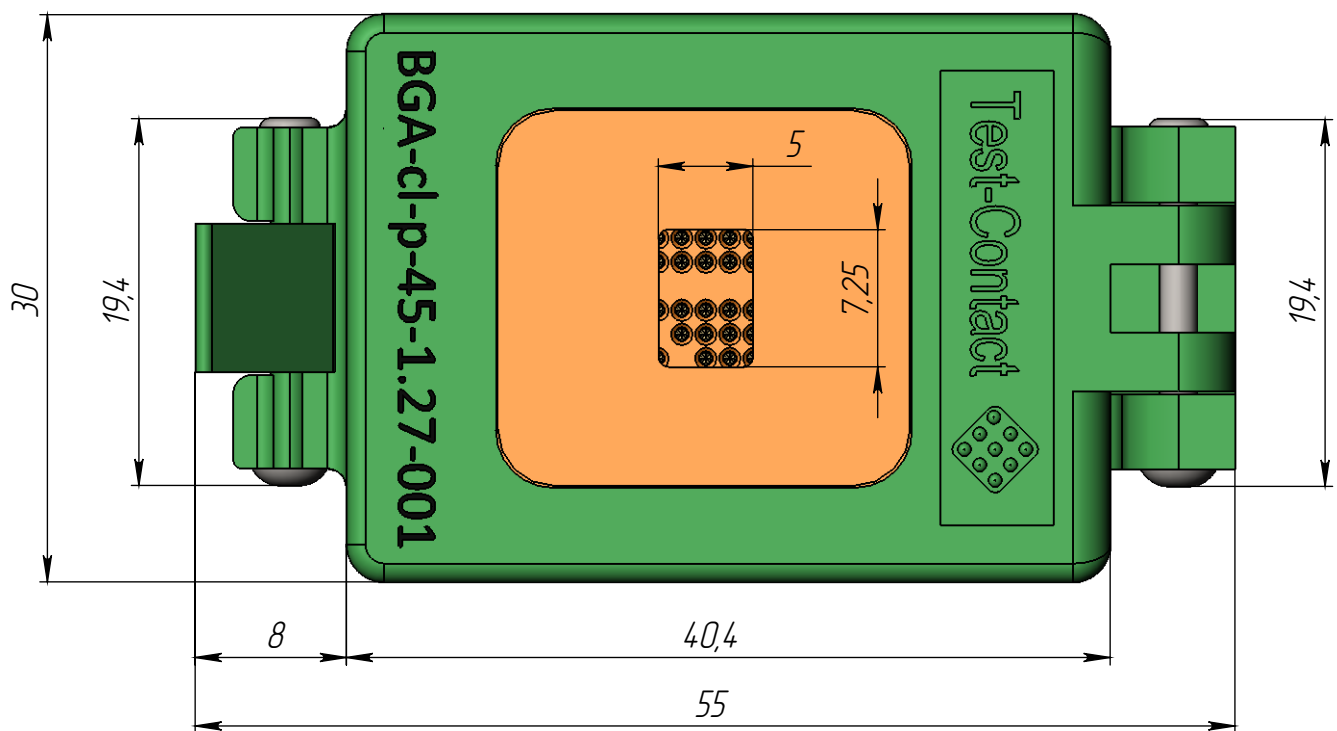
____/____2017г.

*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-45-1.27-001*

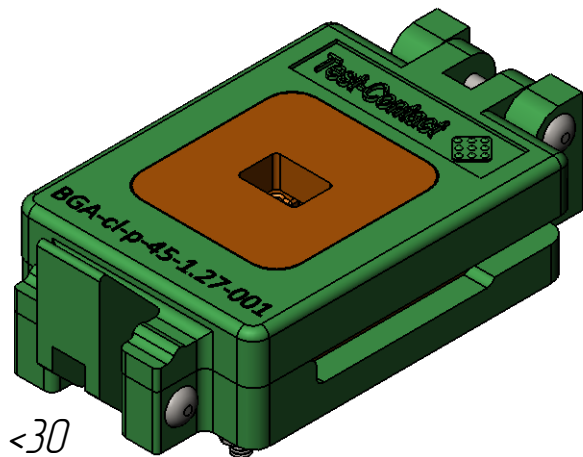
Внешний вид и габаритные размеры КУ
BGA-cl-p-45-1.27-001



- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

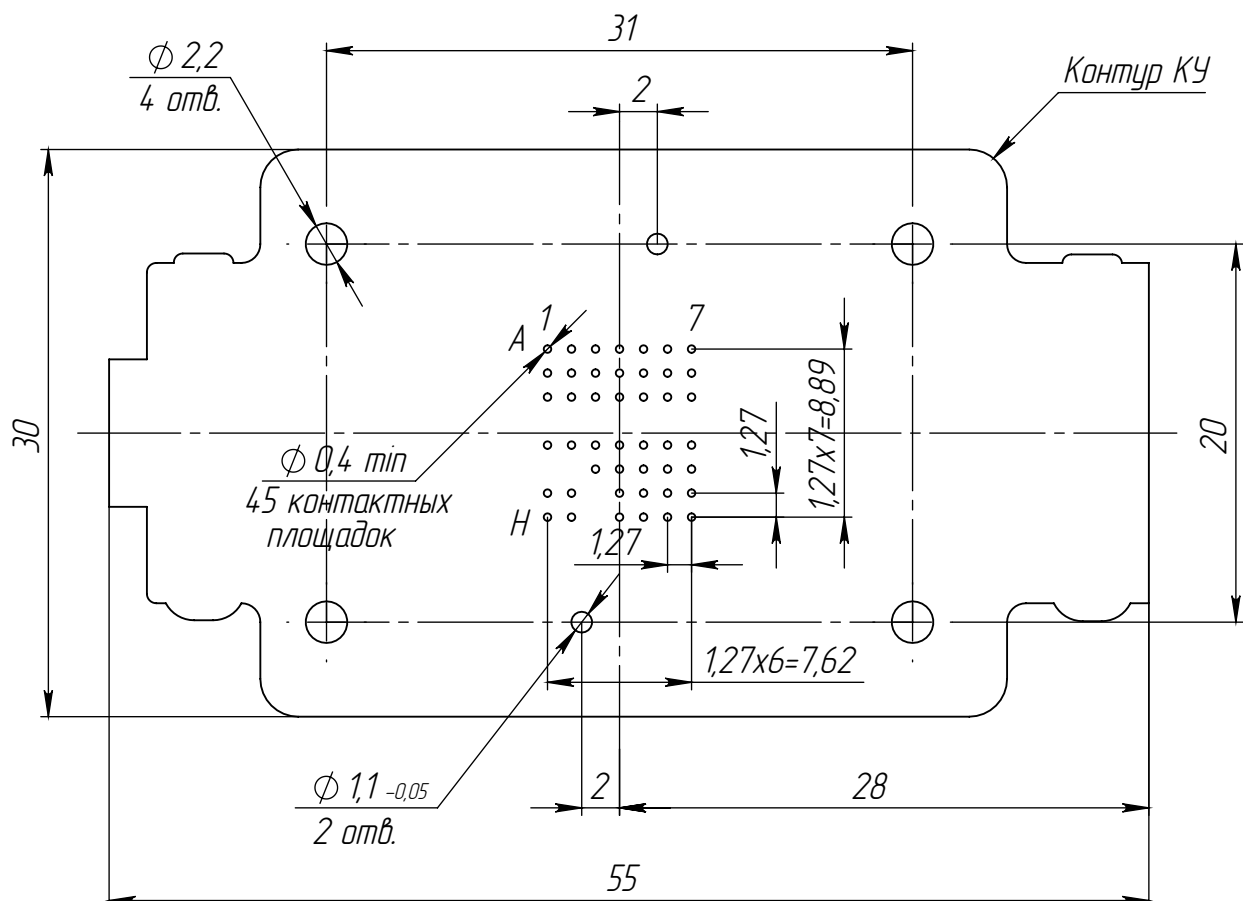


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 45
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1



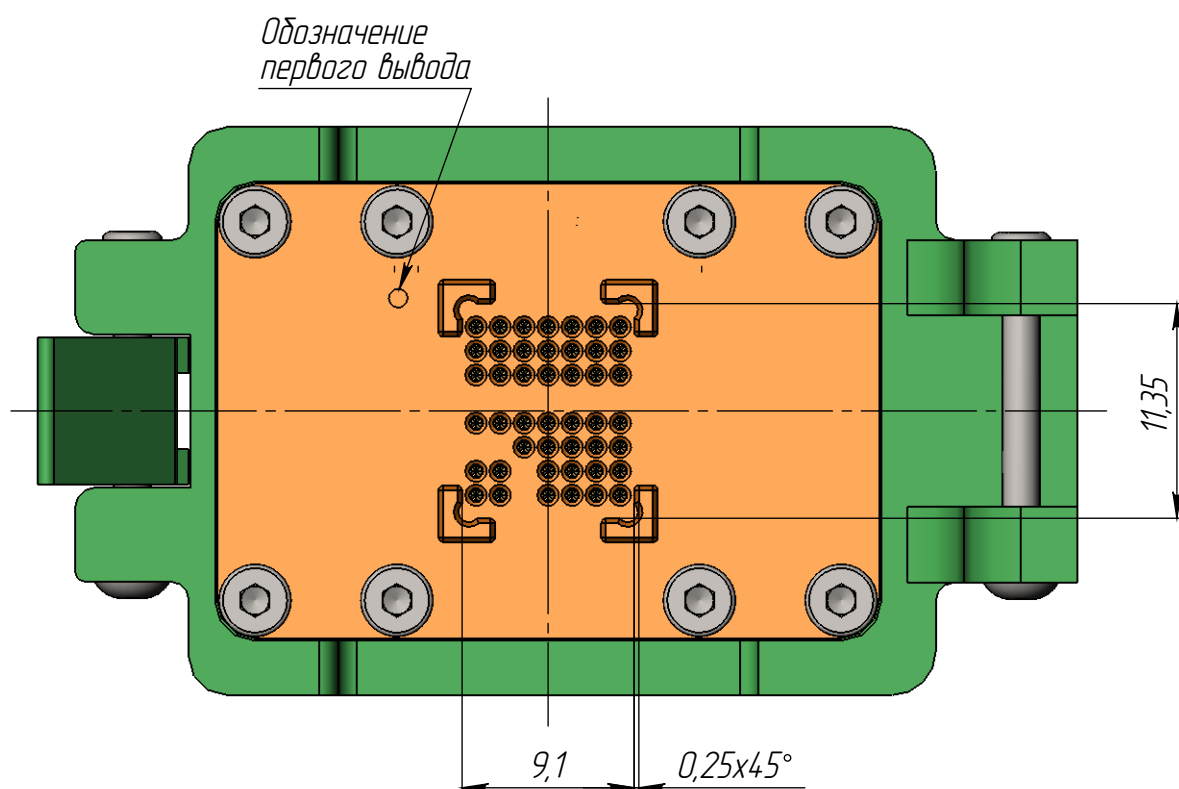
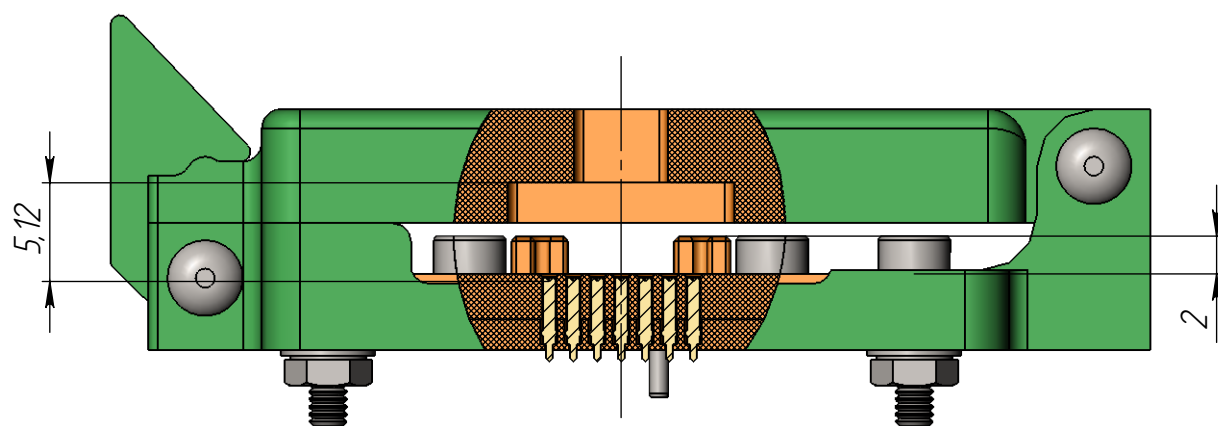
Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

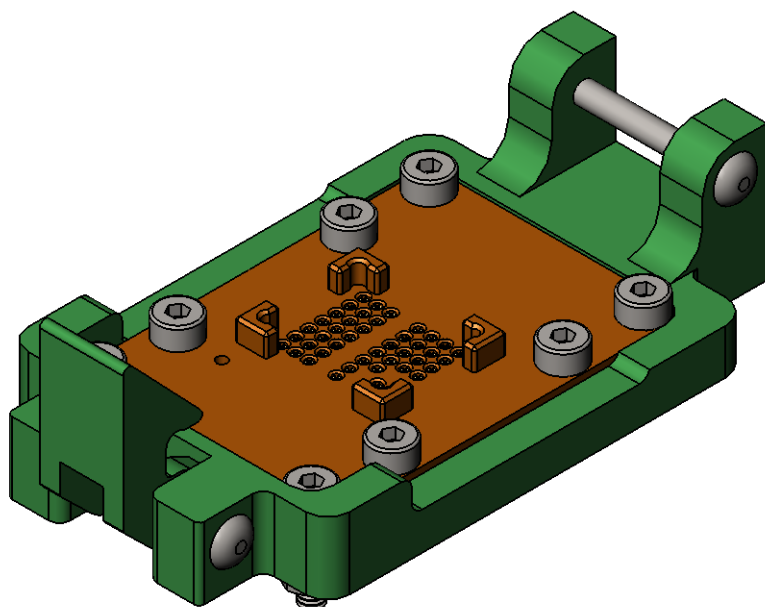


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.

Место установки ЭРИ

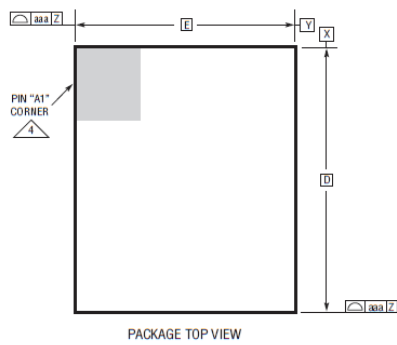


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

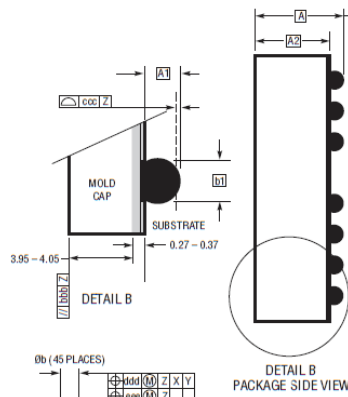


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

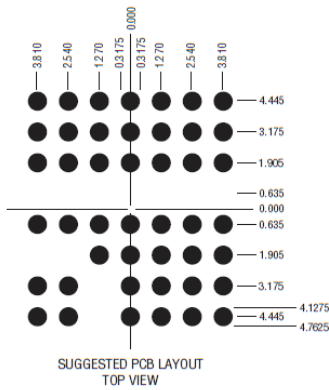
BGA Package 45-Lead (11.25mm × 9.00mm × 4.92mm) (Reference LTC DWG # 05-08-1869 Rev A)



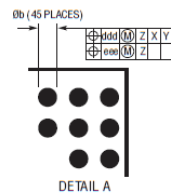
PACKAGE TOP VIEW



DETAIL B
PACKAGE SIDE VIEW

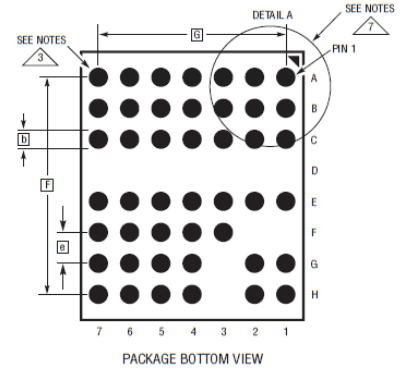


SUGGESTED PCB LAYOUT
TOP VIEW



DETAIL A

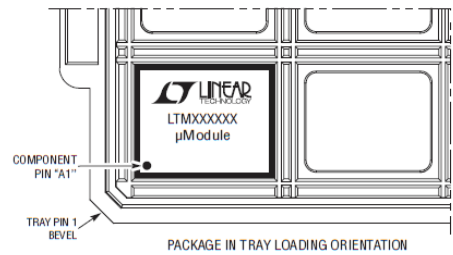
DIMENSIONS				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX	NOTES
A	4.72	4.92	5.12	
A1	0.50	0.60	0.70	
A2	4.22	4.32	4.42	
b	0.71	0.78	0.85	
b1	0.60	0.63	0.66	
D		11.25		
E		9.0		
e		1.27		
F		8.89		
G		7.62		
aaa			0.15	
bbb			0.10	
ccc			0.20	
ddd			0.30	
eee			0.15	
TOTAL NUMBER OF BALLS: 45				



PACKAGE BOTTOM VIEW

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
3. BALL DESIGNATION PER JEDEC MS-028 AND JEP95
4. DETAILS OF PIN #1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL, BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED. THE PIN #1 IDENTIFIER MAY BE EITHER A MOLD OR MARKED FEATURE
5. PRIMARY DATUM -Z- IS SEATING PLANE
6. SOLDER BALL COMPOSITION IS 96.5% Sn/3.0% Ag/0.5% Cu
7. PACKAGE ROW AND COLUMN LABELING MAY VARY AMONG μ Module PRODUCTS. REVIEW EACH PACKAGE LAYOUT CAREFULLY



PACKAGE IN TRAY LOADING ORIENTATION

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.